

牢记嘱托 感恩奋进 · 梁平

梁平 打造川渝东北边际地区集成电路特色产业高地

集成电路,被誉为工业粮食,是国家战略性、基础性和先导性产业,也是电子信息产业的基石。近年来,梁平区抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,聚焦“强链攻坚、创新突围、生态重构”三个维度,坚持产业高端化、智能化、绿色化发展,通过强链补链锻造产业集群、创新驱动突破技术壁垒、数智赋能重塑生产效能、梯度培育构建产业生态,打造川渝东北边际地区集成电路特色产业高地,为全市构建“33618”现代制造业集群体系贡献力量。



梁平区集成电路产业园 摄/向成国



重庆梁平高新技术产业开发区 摄/熊伟

强链攻坚 规模能级加速跃升

今年第一季度,梁平集成电路产业又添新成员,晶晨光电、科力光电等6个上下游项目签约落地,总投资约13.6亿元,弥补了当地光电探测芯片及模组空白。

至此,梁平区共有集成电路企业32家,其中规上企业9家,已形成“封装+模组+显示+线束+终端应用”产业集群。“梁平集成电路产业起步于2007年,“梁平区委发改委相关负责人介绍,平伟实业过去以生产最简单的功率半导体器件——电子二极管为主,2007年落户梁平后,创新开发多晶体的功率半导体器件,到现在成为一家集芯片设计、封装、应用与可靠性检测服务一体化的功率半导体IDM产业公司,“无中生有”填补了梁平电子信息产业的空白。“到2023年,产值超10亿元。”

今年以来,梁平区围绕平伟实业等链主企业,绘制集成电路产业图谱和重点企业生态图谱,精准延链补链,聚力推进现代制造业集群体系能级和竞争力全面提升,产业链韧性持续增强。

一方面巩固拓展存量企业集群优势,重点支持平伟实业、捷尔士等企业扩大车规级芯片、功率半导体、新型显示等产能;一方面大力推动传统产业转型升级,把握“两新”政策助力扩围机遇,深化制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。

一年来,梁平强化专项资金和技改专项支持,集成电路产业新实施技术改造

项目10个以上,带动更新设备150台(套)以上,技改投资增长20%以上。平伟实业与三星、联想、台达、博世等世界500强企业建立稳定配套关系,产品覆盖汽车电子、光伏逆变器、智能终端等领域。

“同时全力以赴招大引强,奋力开拓航天电子新赛道。”梁平高新区相关负责人表示,通过健全产业链招商、基金招商、场景招商、科技招商等新模式,布局智能传感器、AI芯片等前沿领域,重点对接长三角转化中心、固高科技、富华电子、宣益科技等优质项目,加快构建规模化、集群化现代产业体系。

截至目前,特种飞行器智慧工厂、纵横无人机、鑫航盛、达宁科技、光和精密、平伟吊舱等重大项目已落地,并成功创建国家功率半导体封装测试技术产业化基地、国家级科技企业孵化器、重庆市集成电路特色产业建设基地。

现在,梁平集成电路产业主要集中于产业链下游的封装业,覆盖电源用功率半导体器件研发、制造封装、测试,电子连接器生产等30余个方面,产品广泛应用于笔记本电脑、手机、汽车、家电、安防等领域,为华为、宝骏、三星、DELL、谷歌、亚马逊、联想等全球知名企业配套。

规模能级加速跃升,产业集聚效应凸显。今年1—3月,梁平集成电路产业同比增长24%,占全区工业总产值比重提升至23.5%。



重庆远鸿光电科技有限公司,技术人员在检查智能终端玻璃盖板产品质量 摄/熊伟

创新突围 技术突破驱动发展

4月15日,2025慕尼黑上海电子展(electronics China)在上海国际博览中心举办。参展的平伟实业现场发布十多款新产品,包括半桥驱动模块、三相全桥驱动模块,各类先进封装产品(顶部散热系列产品:TCOP10、DT3PAK、TOLT、ODPACK),这些产品将广泛应用于车规等中高端市场。

“创新引领,推动公司跨越式发展。”平伟实业市场总监游书文介绍,公司持续多年保持研发投入6000万元以上,年设备投入1.5亿元以上,组建了芯片设计团队和产品开发团队,组建了50人以上的车规技术团队,组建了100人以上的高新产品研发团队,研发人员近300人。”

今年2月27日,梁平区政府与电子科技大学签订《政产学研合作协议》,明确联合创建产业孵化中心,开展人才培养、举办各类大会、推进项目建设等事宜。

4月3日,电子科技大学光电科学与工程学院梁平人才工作站将在成都揭牌,工作站将构建“政产学研用”协同创新平台,帮助电子科技大学毕业生深入了解梁平经济社会发展与人才需求状况,构建“价值引领—生态赋能—终身成长”三位一体人才育成体系。

“围绕未来产业和新质生产力,靶向攻坚关键领域。”梁平区相关负责人称,梁平正加速先进传感与光电探测集成研究院芯片应用和前端产业化项目在梁平孵化进度,及时跟进推动项目落地转化。其中,光电探测芯片及模组产业化项目,预计年底实现产业化。



重庆平伟实业股份有限公司,技术人员操作智能化机器设备进行芯片半成品加工 摄/熊伟

智改数转 提质增效动能强劲

4月初,位于梁平高新区集成电路产业园的重庆乐仁汽车电子有限公司(以下简称“乐仁汽车电子”)传来喜讯,今年一季度产值达5700万元,预计到6月底产值可以破亿元。

“一年前,年产能仅有8万套。”乐仁汽车电子经理李勇介绍,去年8月,生产厂房由科技企业孵化园迁入集成电路产业园北区,厂房面积从7000平方米扩充为1.4万平方米。新购投入15台全自动端子机,6条环形流水线。2024年第四季度完成了年产20万套整车线束产能建设。

在梁平,像乐仁汽车电子这样数字化转型故事正持续上演——平伟实业建成全市首个功率半导体智能工厂,应用5G+工业互联网实现全流程自动化,生产周期缩短至48小时,人工成本下降70%,车规级器件良品率提升至98%,打入理想、蔚来等新能车企供应链;

专注于智能终端玻璃盖板的研发制造的远鸿光电,年产玻璃盖板2000万片,建设AI质检系统后产品缺陷识别准确率高达99.9%;

“围绕未来产业和新质生产力,靶向攻坚关键领域。”梁平区相关负责人称,梁平正加速先进传感与光电探测集成研究院芯片应用和前端产业化项目在梁平孵化进度,及时跟进推动项目落地转化。其中,光电探测芯片及模组产业化项目,预计年底实现产业化。



重庆乐仁汽车电子有限公司实现数字化转型,生产车间工人给汽车线束打结 摄/向成国

生态重构 梯度培育释放潜能

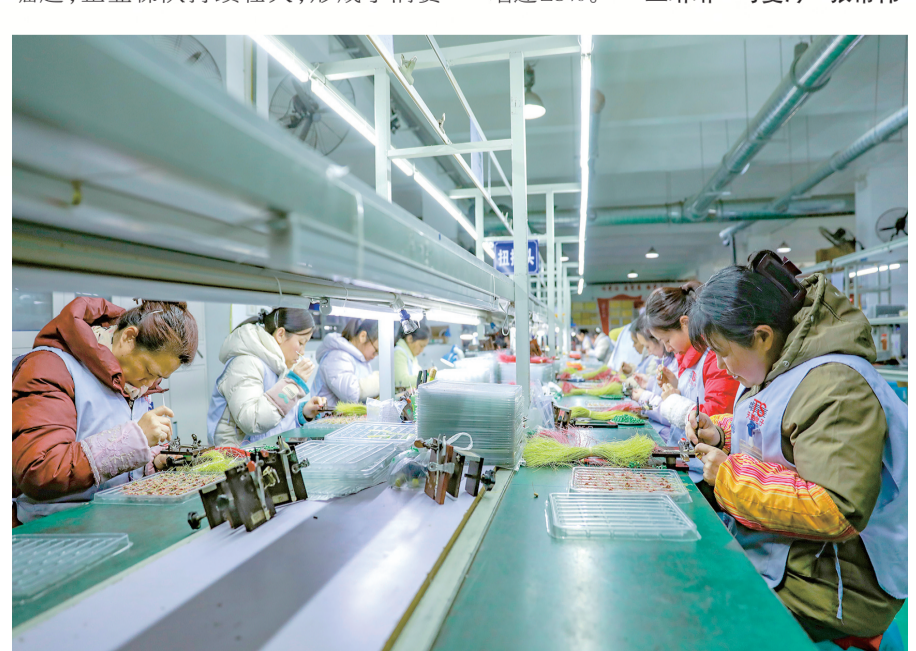
4月13日,重庆天胜电子有限公司(以下简称“天胜电子”)总经理贺秀芳带上新产品赶到上海参加2025慕尼黑上海电子展(electronics China)。

扎根梁平15年,天胜电子凭借在电子变压器生产方面的精湛技术和卓越品质,从一家微型企业成长为国家高新技术企业,80%产品出口欧美。

“生态变了,企业发展方向也要变。”3年前,随着国际市场的变化,天胜电子又转向国内瞄准珠三角、长三角,以及成渝地区市场。去年,企业敏锐捕捉到汽车产业智能化、电动化转型带来了新机遇,开始探索进军汽车线束领域。贺秀芳说,“无论是市场,还是产品,都要围绕多元化布局来适应新变化。”

去年,天胜电子年产值近5000万元,今年第一季度达1500万元,实现“开门红”。现在,贺秀芳又盯上低空经济,正带领团队投身无人机变压器研发,同时又开始细分市场英语和俄语国家,再次谋划进军国际市场。

生态重构,不只是企业。在推进集成电路产业快速发展同时,梁平区构建起“链主+规上+小微”梯度培育机制,推动链主企业创新发展、专精特新集群崛起,企业梯队持续壮大,形成了消费



重庆天胜电子有限公司生产车间,工人在定制订单 摄/熊伟

数说梁平集成电路产业

企业矩阵
累计集聚集成电路企业32家,其中规上企业9家,形成“封装+模组+显示+线链+终端应用”全产业链布局。

产值跃升
2024年龙头企业平伟实业单企产值超10亿元,2024年平伟实业产值突破15.1亿元,占全区产业链总产值的78.6%。

重大项目
建成国家功率半导体封装测试技术产业化基地、国家级科技企业孵化器 etc 3大国家级平台。

全球配套
产品为华为、三星、戴尔、谷歌等全球50+知名企业供货,覆盖汽车、光伏、AI等30余个领域。

研发投入
平伟实业年均研发投入超6000万元,设备投入1.5亿元,研发人员近300人,拥有199项专利(含49项发明专利等,2项国际专利)。

技术突破
平伟实业成功开发国内首个双面散热芯片,填补非制冷红外探测器技术空白,2024年新增专利申请50项。

产学研融合
与电子科大共建光电探测集成技术研究院,联合孵化3个前沿项目;拥有3个国家级研发平台,9个市级创新中心,培育148名产业骨干技术人才。

行业标准
主导制定《功率半导体封装测试规范》,成为国家级智能制造示范项目。

智能升级
80%规上企业实施智改数转,建成5个数字化车间,关键工序数控化率75%。

平伟实业
建成重庆首个功率半导体智能工厂,生产周期缩短48小时,良品率提升至98%,人工成本降70%。

乐仁汽车
电子年产能从8万套跃升至15万套,2024年产值破1.5亿元。

远鸿光电
AI质检系统缺陷识别率达99.9%,手机盖板市场占有率西南第一。

绿色效益
2024年单位产值能耗下降至0.06吨标煤/万元(行业先进水平)。

专精特新
拥有市级专精特新企业8家,2024年新增科技型中小企业12家,捷尔士显示建成西南最大工控屏基地(市场份额25%)。

载体支撑
25万平方米集成电路产业园标准厂房建成投用,启动3万吨/日污水处理厂建设。

未来目标
2025年力争规上企业产值增速25%,新增高新技术企业5家,项目合同引资60亿元,落地率60%。